

R.C. MICROELECTRÓNICA S.A.

Energia, 60-62
Castrobarito 10
Sierra de Aralar, 64

08940 CORNELLA (BCN)
28042 MADRID
20014 SAN SEBASTIAN

TEL.34 - 93 474 48 84 FAX. 34 - 93 474 39 75
TEL.34 - 91 329 55 08 FAX. 34 - 91 329 45 31
TEL.34 - 94 345 92 46 FAX. 34 - 94 347 32 20

NOVEDADES SCHLEGEL

ASUNTO: Perfil en T o flip-flop

Como respuesta a la necesidad de introducir cada vez más y más tarjetas a mayor frecuencia y en racks más pequeños, Schlegel, empresa representada en España por RC Microelectrónica S.A., ha desarrollado el perfil en T o flip flop, una nueva solución para el apantallado EMI de slots de racks de telecomunicaciones, manteniendo continuidad entre ellos y mejorando la efectividad de blindaje.

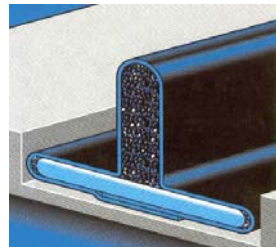
Este perfil puede someterse a fuerzas bidireccionales y posibilita la tolerancia cero en las separaciones entre tarjeta y tarjeta (factor muy importante en entornos tan compactos) sin comprometer el apantallamiento. Es fácil de ensamblar, de bajo coste y no contiene materiales contaminantes.

El perfil en T está formado por espuma de uretano recubierta de un tejido altamente conductor. Este perfil se presenta moldeado en forma de T para soportar fuerzas bidireccionales.

A la base integrada de espuma se conecta a una inserción de policarbonato embutido para asegurar la rigidez en la base.

El perfil se instala como un perfil tradicional en forma de T, sin embargo, cuando una nueva tarjeta se introduce en el rack, el perfil se aplasta en la ranura sin comprometer la efectividad de blindaje y sin ocupar espacio entre tarjeta y tarjeta (a diferencia de otros métodos convencionales de apantallamiento).

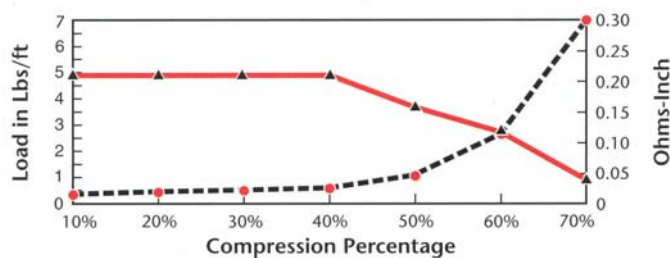
La utilización de este tipo de perfiles aporta otras ventajas como la reducción del ruido acústico y el aumento de circulación de aire para prevenir el sobrecalentamiento del equipo.



Recommended Minimum Compression: 30% Recommended Maximum Compression: 70%

Contact resistance between a shielding gasket and the mating surface is related to applied load and percent compression of the gasket. This table is intended to assist in defining the optimum design range for an application. Determined by commonly accepted test procedures under controlled conditions, these values may differ from actual performance under specific operating conditions. Contact a SCHLEGEL representative for design assistance and additional information.

Contact Resistance and Compression-Load Deflection



● Load force ▲ Contact resistance

Test Method: LP-3001